

Ci sarà un po' di MediaTek nei prossimi moduli AMD RZ600 Wi-Fi 6E per notebook

- Ultima modifica: Venerdì, 26 Novembre 2021 10:36

Pubblicato: Venerdì, 26 Novembre 2021 10:32

Scritto da Palma Cristallo

Mediatek ha un nuovo partner: i prossimi moduli AMD RZ600 (RZ608 e RZ616) saranno basati sul nuovo chipset Filogic 330P di MediaTek e supporteranno 2x2 WiFi 6 (2.4/5 GHz) e WiFi 6E (banda da 6 GHz fino a 7,125 GHz) a velocità fino a 2,4 Gbps.

AMD e MediaTek hanno annunciato la collaborazione per la progettazione congiunta di soluzioni Wi-Fi, a partire dai moduli **AMD RZ600 Series Wi-Fi 6E** contenenti il nuovo chipset **Filogic 330P di MediaTek**. L'annuncio è avvenuto in concomitanza con l'Executive Summit di MediaTek 2021 di questa settimana, nel corso del quale è stato annunciato anche [il primo SoC premium MediaTek Dimensity 9000](#).



Il chipset Filogic 330P, incluso nel portafoglio di soluzioni Wi-Fi di AMD in costante espansione, alimenterà la prossima generazione di **laptop AMD Ryzen e PC desktop nel 2022 e successivi**, offrendo velocità Wi-Fi elevate con bassa latenza e minori interferenze da altri segnali. Il chipset integra anche la tecnologia dell'amplificatore di potenza (PA) e dell'amplificatore a basso rumore (LNA) di MediaTek per aiutare a ottimizzare il consumo energetico e ridurre gli ingombri, per poter integrare Filogic 330P in laptop di tutte le dimensioni.

La stessa AMD ha affermato di aver lavorato a stretto contatto con il chip maker per un'integrazione perfetta delle altre parti, inclusi **moduli USB e PCIe**, per poter coordinare i processori di alimentazione/sospensione con lo stato di attivazione del WiFi. Il processo di

Ci sarà un po' di MediaTek nei prossimi moduli AMD RZ600 Wi-Fi 6E per notebook

- Ultima modifica: Venerdì, 26 Novembre 2021 10:36

Pubblicato: Venerdì, 26 Novembre 2021 10:32

Scritto da Palma Cristallo

ottimizzazione ha inoltre previsto lo stress test e la garanzia di standard di compatibilità, che potranno in definitiva ridurre i tempi di sviluppo per i clienti OEM.

"Crediamo che la combinazione di potenti processori AMD Ryzen con la leadership di MediaTek nelle tecnologie di connettività avanzate fornirà un'esperienza di calcolo incredibile a livello generale"

Saeid Moshkelani, senior vice president and general manager, client business unit, AMD.

In particolare nel modulo **AMD RZ608**, troviamo un modulo M.2 2230 che supporta 2x2 Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 tramite canali a 80 MHz con una velocità PHY fino a 1.2Gb/s. **AMD RZ616**, invece, supporta canali Wi-Fi a 160MHz ed è disponibile nelle SKU M.2 2230 e 1216 con una velocità PHY fino a 2.4 Gb/s.

"MediaTek è già leader nel Wi-Fi in diversi segmenti, tra cui smart TV, router e assistenti vocali. Il chipset Filogic 330P amplia il nostro portafoglio di connettività mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza nel mercato dei PC",

Alan Hsu, corporate vice president and general manager, Intelligent Connectivity at MediaTek.